

Gute Gründe, DGZfP-Mitglied zu werden:

In der DGZfP e.V. ist jeder herzlich willkommen, der sich der Zerstörungsfreien Prüfung verbunden fühlt. Als Mitglied werden Sie laufend über das aktuelle Geschehen auf dem Gebiet der zerstörungsfreien Materialprüfung unterrichtet.

Wir gewähren unseren Mitgliedern günstige Konditionen für die Teilnahme an Kursen und Tagungen sowie beim Kauf unserer Publikationen. Die „ZfP-Zeitung“ mit aktuellen Berichten und Fachartikeln erscheint fünfmal jährlich und wird unseren Mitgliedern unentgeltlich zugesandt.

Im geschlossenen Mitgliederbereich unserer Homepage erhalten unsere Mitglieder Zugriff auf das Mitgliederverzeichnis, die Informations-Drehscheibe Normung und weitere interne Kommunikationsplattformen.

Sie sind herzlich eingeladen, in unseren Fachausschüssen und Gremien mitzuarbeiten. Nicht zu vergessen: Die vielfältigen Kontakte zu Experten und Fachkollegen in einem Fachverband.

Die DGZfP vertritt die Interessen der in der ZfP beschäftigten Menschen!

Wenn Sie sich jetzt für eine Mitgliedschaft entscheiden und dies auf der Anmeldung für diese DGZfP-Veranstaltung vermerken, gelten für Sie ggf. schon die Mitgliederermäßigungen.

Wir freuen uns auf Ihre aktive Mitarbeit als unser Mitglied.

ORGANISATION

- Anmeldung** bis **05.11.2013** an die Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung e.V. Max-Planck-Straße 6, 12489 Berlin
Tel.: +49 30 67807-121/-122
Fax: +49 30 67807-129
E-Mail: tagungen@dgzfp.de
www.dgzfp.de/seminar/symposiummc
- Gebühr** Teilnahmegebühr 150,00 €
Teilnahmegebühr für Studenten ohne HSA 75,00 €
inkl. Pausenbewirtung, Mittagessen und Tagungsunterlagen
- Stornierung** bis 25.10.2013: 50 % der Teilnahmegebühr
ab 26.10.2013: keine Erstattung möglich
- Überweisung** nach Erhalt der Rechnung bis **12.11.2013** (Eingang DGZfP)
- erbeten an** Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung e.V.
Berliner Volksbank
Konto-Nr. 5940 040 002 (BLZ 100 900 00)
Bitte vermerken Sie auf Ihrer Überweisung **unbedingt die Rechnungsnummer und den Teilnehmernamen.**
- Tagungsunterlagen** Alle Teilnehmer erhalten zur Veranstaltung eine Broschüre mit den Kurzfassungen der Beiträge. Die von den Autoren zur Veröffentlichung freigegebenen Präsentationen sind nach der Tagung auf der Tagungs-Homepage als PDF zum Download verfügbar.
- Tagungsort** BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Ludwig-Erhard-Saal
Unter den Eichen 87, 12205 Berlin
- Hotelreservierung** Unsere Empfehlung (Nähe zum Tagungsort):
• **Best Western Plus Hotel Steglitz International**
• **Seminaris CampusHotel Berlin**
• **Residenz 2000 Aparthotel**
Ausführliche Informationen finden Sie unter www.dgzfp.de/seminar/symposiummc
Bitte nehmen Sie die Reservierungen selbst vor!
- Sitzungen am Rande** 20.11.2013, 10:00 Uhr,
Sitzung des FA Materialcharakterisierung (FA-Mitglieder erhalten eine separate Einladung)

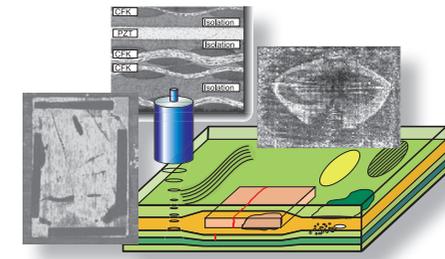


DEUTSCHE
GESELLSCHAFT FÜR
ZERSTÖRUNGSFREIE
PRÜFUNG E.V.

EINLADUNG PROGRAMM

Symposium

Zerstörungsfreie Materialcharakterisierung



19. November 2013, Berlin

VORWORT

Der Fachausschuss Materialcharakterisierung der Deutschen Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung veranstaltet nach längerer Pause wieder ein Symposium, zu dem wir alle Fachkolleginnen und -kollegen herzlich einladen.

Bestandteil der Materialwissenschaft ist die Aufklärung der Struktur und Eigenschaften moderner Konstruktionswerkstoffe und Werkstoffverbunde. Der Fachausschuss Materialcharakterisierung der DGZfP hat sich zum Ziel gesetzt, hierzu die existierenden zerstörungsfreien Prüfverfahren zu systematisieren, weiter zu entwickeln und zu qualifizieren. Nur im Verständnis der Wechselwirkung von ZfP-Verfahren (z. B. Ultraschall, Röntgendurchstrahlung, Röntgenbeugung...) und Werkstoff kann eine Anomalie erkannt, lokalisiert und vermessen werden.

Im Fachausschuss Materialcharakterisierung steht folglich der Werkstoff im Mittelpunkt und nicht die ZfP-Methoden. Ziel ist es, mit unterschiedlichen ZfP-Verfahren den Werkstoff hinsichtlich seiner physikalischen Eigenschaften möglichst effizient und umfassend zu charakterisieren. Somit ist die Suche von Defekten auch nicht die zentrale Aufgabe, sondern das Gewinnen konkreter Materialparameter, was nicht immer leicht zu erreichen ist. Neben vielfältigen Forschungsthemen werden verschiedene Verfahren der Materialcharakterisierung genutzt, um in-situ in Produktionsprozessen die intrinsischen Eigenschaften von Werkstoffen und Werkstoffverbunden zu bestimmen und somit die Qualität zu überwachen.

Mit dem Symposium möchten wir Kollegen aus Forschung, Verfahrensentwicklung und Anwendung zusammen bringen, für die die zerstörungsfreie Materialcharakterisierung von großem Interesse und Nutzen ist. Das diesjährige Programm ist ein Ausschnitt aus den vielfältigen Arbeitsgebieten unseres Fachausschusses.



Dr.-Ing.
Volker Trappe
Vorsitzender des
DGZfP-Fachausschusses
Materialcharakterisierung



Dr.-Ing.
Matthias Purschke
Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied
der DGZfP

VORTRÄGE

DIENSTAG, 19.11.2013

- 10:00 **Begrüßung**
U. Panne, Präsident der BAM, Berlin;
V. Trappe, Vorsitzender des DGZfP-FA MC
- VORTRAGSBLOCK I**
J. Opitz, Fraunhofer IZFP, Dresden
- 10:15 **1 Die neue Normenreihe IEC 62631 – dielektrische und resistive Materialcharakterisierung an festen Isolierstoffen der Elektrotechnik**
H. Haupt, MPA-IFW, TU Darmstadt
- 10:55 **2 Schichtdickenmessung mit Röntgenfluoreszenz: Kalibrierung versus standardfreie Methoden. Wie wird die Rückführbarkeit gewährleistet?**
B. Nensel, Helmut Fischer, Sindelfingen
- 11:35 Pause
- 11:55 **3 Charakterisierung von Stahlwerkstoffen mit Ultraschallmethoden**
M. Stolzenberg, Salzgitter Mannesmann Forschung, Salzgitter
- 12:35 **4 Charakterisierung von Cordierite mit unterschiedlichen Methoden (X-ray, Neutronen)**
G. Bruno et al., BAM, Berlin
- 13:15 Mittagspause
- VORTRAGSBLOCK II**
J. Bamberg, MTU Aero Engines, München
- 14:15 **5 Mikrorissbildung in Faser-Kunststoff-Verbunden charakterisiert mit SAXS – Materialforschung und Praxis**
V. Trappe, BAM, Berlin
- 14:55 **6 Zerstörungsfreie Charakterisierung und Prüfung faserverstärkter Kunststoffkomposite mit akustischen Verfahren**
T.B. Helfen, C. Boller, U. Rabe, Fraunhofer IZFP, Saarbrücken
- 15:35 Pause
- 15:55 **7 Analyse dielektrischer Eigenschaften von Harzsystemen für CFK mittels Hochfrequenz-Wirbelstromverfahren**
S. Gäbler, H. Heuer, Fraunhofer IZFP, Dresden
- 16:35 **8 Richtlinie Zerstörungsfreie Materialprüfung**
L. Spieß, TU Ilmenau; V. Trappe, BAM, Berlin;
J.D. Schnapp, FSU Jena; B. Nensel, Helmut Fischer, Sindelfingen; G. Teichert, MFPA Weimar, TU Ilmenau
- 17:15 **Schlusswort**
und Ausklang bei Getränken und Snacks bis 19:00 Uhr

Bitte bis **05.11.2013** zurücksenden an
DGZfP, Max-Planck-Straße 6, 12489 Berlin

**ANMELDUNG zum Symposium Zerstörungsfreie
Materialcharakterisierung**
19. November 2013, BAM, Berlin

Name
Vorname
Titel
Telefon
Fax
E-Mail
Firma, Anschrift: <i>(Gilt auch für die Teilnehmerliste und für den Versand der Unterlagen.)</i>

Teilnahmegebühr 150,00 €
Teilnahmegebühr für Studenten ohne HSA 75,00 €

Wir bitten um Überweisung der Teilnahmegebühr nach Erhalt der Rechnung bis 12.11.2013 auf unser im Programm genanntes Konto unter Angabe der Rechnungsnummer und des Teilnehmersnamens.

Mit der Aufnahme meiner Anmelde Daten in eine Teilnehmerliste, die den Referenten und den übrigen Teilnehmern zur Verfügung gestellt wird*,

bin ich einverstanden bin ich nicht einverstanden

Ich habe Interesse an einer Mitgliedschaft in der DGZfP

Datum	Unterschrift
-------	--------------

*Datenschutz-Hinweis

Alle Angaben werden gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) behandelt, Ihre Daten werden nicht an unbefugte Dritte weitergegeben.

Externe Dienstleister, die im Auftrag der DGZfP e.V. arbeiten, sowie die DGZfP Ausbildung und Training GmbH gelten jedoch nicht als Dritte. An Sponsoren und Mitveranstalter werden keine personenbezogenen Daten weitergegeben.

Wir machen Sie ausdrücklich auf Ihr Widerspruchsrecht gegen die Verwendung Ihrer Daten zu Werbe- und Marketingzwecken (BDSG § 28 Abs. 3) aufmerksam. Sie können der Verwendung Ihrer persönlichen Daten zu diesen Zwecken jederzeit widersprechen.